

2020年12月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年12月15日

上場会社名 ウィンテスト株式会社
 コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 姜 輝
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 樋口 真康
 四半期報告書提出予定日 2020年12月15日
 配当支払開始予定日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
 TEL 045-317-7888

(百万円未満切捨て)

1. 2020年12月期第1四半期の連結業績(2020年8月1日～2020年10月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年12月期第1四半期	186	155.1	131		130		142	
2020年7月期第1四半期	72	126.2	151		151		152	

(注) 包括利益 2020年12月期第1四半期 126百万円 (%) 2020年7月期第1四半期 152百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年12月期第1四半期	4.32	
2020年7月期第1四半期	7.25	

当社は、2020年12月期より決算期(事業年度の末日)を毎年7月31日から毎年12月31日に変更しております。当第1四半期連結累計期間について、当社及び国内の連結子会社は3ヶ月間(2020年8月1日～2020年10月31日)、海外の連結子会社は4ヶ月間(2020年7月1日～2020年10月31日)を連結対象期間とした変則的な決算となっております。詳細につきましては、2020年11月18日発表の「決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年12月期第1四半期	2,190	1,945	88.7
2020年7月期	2,402	2,070	86.1

(参考) 自己資本 2020年12月期第1四半期 1,942百万円 2020年7月期 2,068百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年7月期		0.00		0.00	0.00
2020年12月期					
2020年12月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、事業年度の末日を毎年7月31日から毎年12月31日に変更しております。このため移行期間にあたる2020年12月期は5ヶ月の変則決算となります。これにともない、2020年12月期(予想)の1株当たり配当金につきましては0.00円を予定しております。

3. 2020年12月期の連結業績予想(2020年8月1日～2020年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	795		35		37		24		0.73

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

2020年12月期は決算変更の経過期間となり、5ヶ月の変則決算となりますので、第2四半期の予想数値は記載しておりません。また、通期については、12月決算の子会社は6ヶ月間(2020年7月1日～2020年12月31日)を連結対象期間とした予測数値を記載しております。このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年12月期1Q	33,041,000 株	2020年7月期	33,041,000 株
期末自己株式数	2020年12月期1Q	株	2020年7月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年12月期1Q	33,041,000 株	2020年7月期1Q	21,084,478 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。

また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
四半期連結損益計算書	8
第1四半期連結累計期間	8
四半期連結包括利益計算書	9
第1四半期連結累計期間	9
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11
3. その他	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当連結会計年度における世界経済は、2020年1月末から顕在化してきた、新型コロナウイルスの感染の爆発的な拡大を受け、大きな打撃を受けました。2020年8月以降小康状態が続いておりましたが、10月に入り感染の第三波とみられる再拡大が問題となっております。その影響は多くの企業業績に影を落とし低迷が続いています。今後引き続き雇用・所得環境の悪化、経済の回復には相当の時間が必要との政府見解ですが、2020年後半から、2021年にかけて、コロナ禍の一段落した中国を中心に、経済活動は活発化しており、それを背景に大手電機産業メーカー等において、強気の業績予想が見られるようになってまいりました。しかし世界的には西側諸国を中心とした新型コロナウイルス禍の猛威ははまだ衰えておらず、加えて米中貿易摩擦の長期化に伴う中国経済の見通しや今後の政策に関する不確実性などを懸念する意見もあり先行きに不透明な状況があることも事実です。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界におきましては、上述の5Gまたそれに伴う新サービスの台頭など高速通信技術が先導役となり情報端末は勿論、テレビなど画面の4K、8K化など高精細化、LCDに続き有機EL、そして車載パネル、家電にもディスプレイパネルが採用されるなど「表示デバイス市場」は、年平均成長率(CAGR)4%(IHI予測)で安定的に成長していくと考えられています。また物のIoT化技術の進展により「半導体市場全般」は引き続き成長していますが、その需給バランスは米中問題が火種にもなり得、依然不安定な要素を含みます。

このような環境のなか、当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、数年前より、スマートフォン向け半導体分野への精力的な設備投資が続いてきたアジア市場(中国及び台湾)にビジネスチャンスを求め、現地の顧客ニーズに適合したLCDドライバーIC検査装置を開発するとともに、台湾に本社を置く有力代理店の協力のもと、中国・台湾のマーケットに集中した営業の展開をしております。その結果、当該検査装置については、2020年3月に中国の顧客から、大口受注をそして追加でイメージセンサーシステムの受注を獲得いたしました。しかし2020年1月から顕在化してきた、新型コロナウイルス禍の世界的な拡大によって、お客様工場に大きな影響が出ることとなり、顧客から工場の受け入れ態勢麻痺との理由で繰り延べとなったことから、それらの納入売り上げは当28期となりました。その後顧客との納入時期調整から、当第1四半期は低調に推移し、売上は第1四半期以降、期末に集中することになりました。また、2020年10月29日に開催しました定時株主総会で当社の決算期の変更を決議頂きましたので、当第28期は5カ月間となり12月31日で年度末決算となることから旧第28期の上半期(1月末まで)に予定していた受注残にかかわる納品と売上の一部は当社グループ第29期になります。

新規事業である新エネルギー関連事業においては、太陽光発電システムの保守点検・整備・保証管理領域の案件獲得に加え、ITを使った管理システム構築に注力する戦略として、キントーンを使った管理システムの開発、ビッグデータを取り扱うサーバを利用したビジネス展開や、他の事業者向けに管理システムの構築に関するアドバイスを有料で提供するなど、新しい取り組みに対して積極的に「21世紀型のO&M」を目指した戦略を取っています。また前期から、特に将来を見据えた新たなアライアンスとして、「IT技術で管理する太陽光O&M業界」を積極的に推進する取り組みを念頭に置き、より広範囲且つ緻密な管理体制を築くシステムづくりに邁進し、太陽光発電所オーナーにとり、利益の最大化と安心できる管理サポート情報を届けることが出来る取り組みを開始し、実現してまいります。今後の事業の多角化への取り組みとして、同業他社複数社との協業を行い、顧客の要望に高いレベルで応え企業価値の増大につなげる経営戦略をとる計画です。

このような状況より、当第1四半期連結累計期間の当社グループの売上高は186,196千円(前年同四半期比155.1%増)、営業損失131,625千円(前年同四半期は営業損失151,313千円)、経常損失130,382千円(前年同四半期は経常損失151,917千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失142,808千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失152,779千円)となりました。

なお、セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

①半導体検査装置事業

半導体検査装置事業においては、上述のように、前期からの受注残の出荷は主に当第1四半期以降となったことから、売上の多くは当期期末に集中することとなりました。この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は128,069千円(前年同四半期比286.3%増)、営業損失129,351千円(前年同四半期は営業損失145,018千円)となりました。今後更なる受注獲得のために、顧客のニーズに対応した装置と機能拡張オプションの開発・改善を継続し、検査機能の拡充と高速化を図るとともに、当社の中国・台湾における有力販売代理店「蔚華科技股份有限公司」と協力、連携を深め中国市場により強い攻勢をかけ、同社の顧客サポートチェーンを生かし、売上拡大と新規顧客の開拓に向けた積極的な営業活動を継続してまいります。

②新エネルギー関連事業

新エネルギー関連事業においては、国内において増加傾向にある新型コロナウイルス禍の影響で活動に制限があるものの、新規O&M案件開拓、小・中規模ソーラー発電所の是正工事などが主な受注となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は56,422千円(前年同四半期比43.6%増)、営業損失470千円(前年同四半期は営業損失5,084千円)となりました。

また、前期から始めた取り組みとして、自社用に構築した「太陽光O&M業務支援システム」を販売する計画を立て、その販売につなげるための導入コンサルティングを協業先と共に整備の開始を致しました。ウェアラブル端末との連携によるスマートメンテナンスの実現を目指し、太陽光業界の効率化を提案してまいります。

（2）財政状態に関する説明

（資産）

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ218,149千円減少し、2,164,039千円（前連結会計年度末比9.2%減）となりました。この主な要因は、現金及び預金が419,850千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ5,870千円増加し、26,384千円（前連結会計年度末比28.6%増）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が5,870千円増加したことによるものです。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度に比べ84,320千円減少し、195,242千円（前連結会計年度末比30.2%減）となりました。この主な要因は、買掛金が37,184千円、前受金が34,209千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ2,699千円減少し、49,681千円（前連結会計年度末比5.2%減）となりました。この主な要因は、長期借入金が1,794千円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度に比べ125,259千円減少し、1,945,499千円（前連結会計年度末比6.0%減）となりました。この主な要因は、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が142,808千円減少したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社が「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、テレワークやリモートワークで需要が高まるPCや、タブレットそして、スマートフォン等に代表される特に進化の早い情報端末に多く使用され、タイムリーな技術革新が当該検査装置にも求められております。また、それら情報端末ではLCDドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も同時に大きく伸びてまいります。当社では高品位、低コスト、高速化の開発は勿論のこと、更にユーザーフレンドリーなGUI機能強化をそれぞれ推し進め、新たな検査ニーズに対応する検査技術や手法の開発を継続するとともに、随時開発体制の見直しと強化を行ってまいります。

当社グループは、今後大きな成長を遂げると期待されている中国・台湾の市場に本格参入するため、蔚華科技股份有限公司と共同で営業戦略を推し進めており、道半ばではあるものの、検査装置の事業再生に「全集中」で取り組んでおり確実に歩を進めております。中国の半導体政策の支援を受けられるように当社100%の製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」での量産数量の拡大とベンチマークのできる「現地サポート拠点」の設立、立上を進め、各拠点へのデモ機の配備等を進めております。デザインバイジャパンのブランドを全面に出し、ジャパノクオリティを維持しつつ、「9割以上の部品を現地で調達」を原則に製造ラインを構築しました。そのために現地での優秀な人員を確保、拠点を整備し、サプライヤーやマシナリーとの良好なリレーションの構築、そして営業面では受注体制の拡充とスピードアップ、また、拠点からの直接サポート、納入ができる体制を整備し、シェアの拡大、会社価値の増大につなげ株主の皆様への期待に応えてまいります。

今後の当社グループの重要戦略の一つとして、中国工場におけるコストの削減と顧客対応力の両方を強化、さらに最終組立工程のローカライズについては中国の国策である「内製化」政策に合致させる戦略を取り、中国国内市場への深耕を図る予定です。具体的な戦略として、中国国内に複数の機能を持った拠点（営業とプリ・ポスト両方のサポート、パーツセンター）を築くことが必要であり、その前提条件として、日本国内における技術開発力、そしてサポートやパーツセンターの統括機能を整備することが必要であると考えます。当社はファブレスを改め、2019年3月に大阪事業所（開発製造工場）を開設、2020年1月に中国湖北省武漢市で量産製造工場の操業を開始、今後半導体市場において大きな成長を遂げる中国マーケットに本格的に進出できる条件を整えることができました。2020年は世界的に新型コロナウイルス禍が経営を直撃しましたが、2021年当社第29期においては、武漢精測電子集団（グループ）のバックアップを背景に、兄弟会社の技術や販売網をも利用した取り扱い製品の拡充、拠点の整備、営業・サポートのローカライズ等を推し進め、中国、台湾マーケットからの大量受注、受注に見合った量産体制の確立を進めるとともに、当社グループの体制強化に努めてまいります。これにより、スピーディーで顧客満足度の高いサービスの提供ができるとともに、部品調達戦略が社内で行えるようになり、コスト削減、製造品質管理及び大量受注の際であっても納期の短縮などが見込まれます。今後、業績を上げることは勿論、開発環境の更新、人材育成及び増員など組織の充実を行い、今までできなかった機動的な攻めの設計、開発及び製造、それらの強化を目指し顧客満足度を上げることで受注増を図ってまいります。

新エネルギー関連事業では、新型コロナウイルス禍により活動が制限されているなか、太陽光発電システムの保守点検・整備・保証管理領域の受注戦略を採り、業績は上向いたものの、やはり新型コロナウイルス禍の影響で現地作業などに大きな影響が出ました。また、ITを使った管理システム構築に注力する戦略としてキントーンを使った管理システムの構築、ビッグデータを取り扱うサーバを利用したビジネス展開や、他の事業者向けに管理システムの構築に関するアドバイスを有料で提供するなど、新しい取り組みに対して積極的に「21世紀型のO&M」を目指した戦略を採っております。それと同時に新たなアライアンスとして、「IT技術で管理する太陽光O&M業界」を積

極的に推進する取り組みを念頭に置き、より広範囲且つ緻密な管理体制を築くシステムづくりに邁進し、太陽光発電所オーナーにとり利益の最大化と安心できる管理情報を届けることができる取り組みを開始し、実現してまいります。

半導体IoTセンサー分野では、茨城大学との部分影補償機能（太陽光パネルの効率向上）一体型コンバータの開発が完了し、2019年11月にはモニタリングソフトウェア（GUI）とともに、試作機を完成させ現場での設置を視野に入れた試作機を完成させました。2020年より必要不可欠となる現地での実証試験など安全面、環境面での試行錯誤を行い、最終製品化のための開発に取り組むはずでしたが、新型コロナウイルス禍による中断を余儀なくされており、現在も再開できておりませんが、続けて新年度にも研究開発予算を組み進めて行く計画です。

また、当該技術はIoTセンサー技術並びにデータサーバー（ビッグデータ）ソフトウェア技術として、検査装置分野で必要とされる様々な方面へも幅広く、応用が可能であることから、今後「IoTセンサー」（センサーによる「センシング」と「通信部分」（データ転送に係る通信））の改善を含む最終製品化に向けてプロジェクトを進める所存であります。

和歌山大学と進めておりました脈波を利用したヘルスケア管理システムは、株式会社TAOS研究所と新たなアライアンスを組むことで、製品化に大きく近づくこととなりました。来期予算に継続的に組み込み、最終製品化に向けて共同開発を進め、製品化を目指します。尚、開発並びに販売に関しましてはTAOS研究所に一任する方向です。開発された研究成果は、今後の検査装置及びIoTセンサービジネスマーケットにおいて新たなシーズ技術の開発に活かしてまいります。

新型コロナウイルス禍の影響は、当面の間続くことが想定され、当社グループの主力事業となる半導体検査装置事業環境は、その市場構造やサプライチェーンなども変化し、当社も体制を敷きなおし変化に対応してまいります。当該期間において、顧客工場の装置受け入れ態勢が整うまでに時間を要したこと、納入時期の調整等から、当第1四半期連結累計期間における受注・売上については、低調に推移し、売上は当期期末に集中することとなりました。また、2020年10月29日に開催しました定時株主総会で当社の決算期の変更を決議頂きましたので、当第28期は12月31日で決算となり、旧第28期の上半期（1月末まで）に予定していた受注残にかかわる納品と売上の一部は当社グループ第29期になります。

連結業績予想などの将来予測に関し、今般の米中貿易摩擦による経済への懸念が依然払拭されない中、競争環境において楽観視はできない状況ではありますが、引続き当社グループとして、台湾、蔚華科技股份有限公司並びに、当社グループ100%出資の偉恩測試技術（武漢）有限公司と連携を強化、顧客開拓を推し進め業績の立て直しを確実なものとしてまいります。

なお、当第28期連結業績予想に関してはサマリー頁に記載の通りであります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,320,719	900,869
受取手形及び売掛金	108,122	102,778
商品及び製品	25,964	27,514
仕掛品	584,449	653,262
原材料及び貯蔵品	207,152	319,136
前渡金	15,989	13,504
未収消費税等	82,693	98,259
その他	37,097	48,714
流動資産合計	2,382,188	2,164,039
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物（純額）	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具（純額）	—	—
工具、器具及び備品	183,739	183,739
減価償却累計額	△183,739	△183,739
工具、器具及び備品（純額）	—	—
リース資産	4,391	4,391
減価償却累計額	△4,391	△4,391
リース資産（純額）	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	23,898	29,768
貸倒引当金	△3,384	△3,384
投資その他の資産合計	20,514	26,384
固定資産合計	20,514	26,384
資産合計	2,402,703	2,190,423

(単位: 千円)

	前連結会計年度 (2020年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	115,235	78,051
未払金	29,986	23,575
1年内返済予定の長期借入金	6,578	7,176
未払法人税等	26,104	8,790
賞与引当金	4,696	9,679
製品保証引当金	3,255	7,957
前受金	50,994	16,784
その他	42,713	43,228
流動負債合計	279,563	195,242
固定負債		
長期借入金	40,010	38,216
リース債務	5,416	4,633
資産除去債務	6,194	6,217
その他	759	614
固定負債合計	52,381	49,681
負債合計	331,944	244,924
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,954,325	2,954,325
資本剰余金	3,061,574	3,061,574
利益剰余金	△3,907,627	△4,050,435
株主資本合計	2,108,272	1,965,464
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△39,603	△23,308
その他の包括利益累計額合計	△39,603	△23,308
新株予約権	2,090	3,344
純資産合計	2,070,758	1,945,499
負債純資産合計	2,402,703	2,190,423

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 （四半期連結損益計算書）
 （第1四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2019年8月1日 至 2019年10月31日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2020年8月1日 至 2020年10月31日）
売上高	72,994	186,196
売上原価	74,488	115,840
売上総利益又は売上総損失（△）	△1,493	70,356
販売費及び一般管理費	149,819	201,981
営業損失（△）	△151,313	△131,625
営業外収益		
受取利息	0	417
為替差益	12	759
その他	166	395
営業外収益合計	180	1,572
営業外費用		
支払利息	425	329
支払手数料	358	—
その他	—	0
営業外費用合計	783	329
経常損失（△）	△151,917	△130,382
特別損失		
減損損失	—	11,530
特別損失合計	—	11,530
税金等調整前四半期純損失（△）	△151,917	△141,913
法人税、住民税及び事業税	862	895
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	862	895
四半期純損失（△）	△152,779	△142,808
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△152,779	△142,808

（四半期連結包括利益計算書）
（第1四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第1四半期連結累計期間 （自 2019年8月1日 至 2019年10月31日）	当第1四半期連結累計期間 （自 2020年8月1日 至 2020年10月31日）
四半期純損失（△）	△152,779	△142,808
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	—	16,294
その他の包括利益合計	—	16,294
四半期包括利益	△152,779	△126,513
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△152,779	△126,513
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自2019年8月1日至2019年10月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント			その他 (注) 3	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	33,154	39,278	72,433	560	—	72,994
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	33,154	39,278	72,433	560	—	72,994
セグメント損失	△145,018	△5,084	△150,102	△1,721	510	△151,313

（注） 1. セグメント損失の調整額510千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自2020年8月1日至2020年10月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)3	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	128,069	56,422	184,492	1,704	—	186,196
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	128,069	56,422	184,492	1,704	—	186,196
セグメント損失	△129,351	△470	△129,822	△2,075	273	△131,625

(注) 1. セグメント損失の調整額273千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

重要な減損はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度においては、営業損失536,443千円を計上、更に昨年12月に設立した中国製造子会社にかかる固定資産を中心とした減損損失80,467千円が加わり、親会社株主に帰属する当期純損失619,587千円を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローは受注に対応するたな卸資産の増加等により1,159,844千円のマイナスとなりました。

また、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの半導体検査装置事業については、3月に台湾の販売代理店から大口受注を獲得していますが、中国・台湾において新型コロナウイルス禍の影響は徐々に薄れつつあるものの、顧客工場の再稼働に時間を要し、その後顧客との納入時期調整から売上は第1四半期以降に集中することとなり、売上高は128,069千円にとどまりました。また新エネルギー関連事業についても、主業務のメンテナンスサービスに加え新規設置工事が加わり、売上高は56,422千円となりました。

よって、当社グループの連結ベース売上高は、前年同期比155.1%増の186,196千円となりましたが、新設した中国子会社の労務費、販管費等が増加したため、営業損失131,625千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を142,808千円計上しております。

当該状況により、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりません。

当社グループはこうした状況を解消するため、以下の取組みを継続して実施しております。

まず、半導体検査装置事業では、通信の5G化につれ、ICの機能面に大きな変化が期待されその技術に応じたタイムリーな検査技術の開発が必須となります。特に当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、テレワークで需要が高まるPCや、タブレットそして、スマートフォン等に多く使用され、また、それら情報端末ではLCDドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も同時に大きく伸びてまいります。当社ではそれらに対応したタイムリーな開発と新たな検査ニーズへの積極的な姿勢が評価され、一昨年度には中国市場にブレイクインを果たし、本年3月には中国新規顧客向けに大口受注を獲得しました。今後更に販売代理店との営業とアフターサポート体制の拡充と強化を進め、中国における販売チャンネルを活かすことで、積極的に複数企業からの追加受注に向けて営業活動をしてまいります。

また、2019年12月には巨大な検査装置マーケットである中国に当該検査装置の組立工場として子会社「偉恩測試技術(武漢)有限公司」を設立し、コストの削減と顧客対応力の両方を強化、さらに最終組立工程のローカライズについては中国の国策である「内製化」政策に合致させる戦略を取り、中国国内市場への深耕を図ってまいります。今後、既存装置に係る工場機能は主に中国子会社に移し、大阪事業所は、一部既存装置の製造能力は残すものの新型次世代装置の開発設計と製造に注力してまいります。

また、台湾、中国顧客向けに開発中の汎用ロジックテスターについては、より広範囲のロジックIC検査に対応するためのアナログオプションの追加機能の開発は完了し、それを強みとして2021年度に受注を見込んでおります。

次に、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用、且つ大阪事業所の技術陣と協働し、今後の市場拡大が見込まれるメモリーデバイス検査分野、5G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携、並びに産学連携を積極的に進め、当該分野への新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

また学校法人慶応義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと進める自重補償機構技術については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う一時中断を経て、再開後に引き続き共同開発で進めてまいります。当該技術は当社の検査装置をウエーハ搬送装置とのドッキングに使用する「マニピュレータ」で製品化を目指しますが、前段階として検査装置のポゴタワーと呼ばれる約25kgの着脱補助装置としてその搬送可能重量を50kgにして開始します。将来的には300kg程度までの重量物を移載することができる機器への製品化を考えております。

IOT分野では茨城大学との部分影補償機能(太陽光パネルの効率向上)一体型コンバータの開発が完了し、2019年11月にはモニタリングソフトウェア(GUI)とともに、試作機を完成させました。2020年は現地での実証試験を計画、最終製品化のための開発に取り組むはずでしたが、新型コロナウイルス禍により中断となりました。今後も研究開発予算を組み進めて行く計画です。

また、経費水準は大阪事業所並びに中国製造子会社の開設に伴う運転資金及び研究開発費等により増加しておりますが、製品の製造委託コストや部材調達につきましては、従前と比較し、スピーディで顧客満足度の高いサービスの提供ができるとともに大幅な製造コスト削減及び、当社100%子会社製造工場となるウインテスト武漢の稼働が開始できたことにより、現地での製品やサポートの品質向上に加え大量受注への対応体制が整いつつあります。

財務面については、2019年7月31日には中国の販売代理店である、武漢精測電子集团股份有限公司と資本提携契約を締結し、同日開催の取締役会において同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2019年9月25日に2,600百万円の資金調達を実施しました。これにより、今後の検査装置事業に必要な中国における工場や拠点設立資金及び開発、運転資金並びに新規事業の展開資金を確保するとともに、併せて財務基盤の強化を図りました。

以上のとおり、台湾、中国を中心とするビジネス機会や受注が増加していること及び今後の運転資金に必要十分な現預金を確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。